

失敗しない電子機器の熱設計と放熱材料の使い方

●日 時：平成30年1月29日(月) 10:30~16:30

●聴講料：1名につき 50,000円（消費税抜、昼食・資料付）

●会 場：[東京・五反田] 日幸五反田ビル8F
技術情報協会セミナールーム

講師：**(株)サーマルデザインラボ 代表取締役 国峯 尚樹 氏**


【講演ポイント】

電子機器ではファンレス、密閉化が進むとともに、熱源であるデバイスの小型化が進んでいる。こうした機器では伝導冷却を主体とした放熱構造が有効になる。しかしながら、熱をうまく伝え(サーマルインターフェース)、うまく拡散する(ヒートスプレッド)構造を採らない限り、熱源の温度は下がらない。そのためには放熱材料を活用しつつ、効率的な熱設計を進める必要がある。本講演では、熱設計の手順と放熱材料の活用方法、温度予測、計測手法のポイントについて解説する。

1. 最近の電子機器の熱問題と熱対策の重要性
2. 伝熱のメカニズムと温度予測式
3. 電子機器の放熱経路による分類
4. 筐体伝導放熱機器と冷媒移動放熱機器
5. 放熱材料の役割と位置づけ
6. LEDやスマホにおける放熱材料の重要性
7. インバータにおける放熱材料の重要性
8. TIMの種類と使い分けおよび選定方法
9. ヒートスプレッダーとしての放熱材料の活用
10. 高放射材料とその効果
11. 高熱伝導樹脂、コンポジット材料の可能性
12. 熱電対による温度測定での問題点
13. 放射温度計(サーモグラフィ)による測定誤差について

「熱設計」セミナー申込書 No.801429 1/29

【講師紹介割引 聴講料2割引】

会社名	〒	事業所・事業部		講師からの紹介として、聴講料を2割引させていただきます。 2名同時申し込み割引との併用はできませんのでご了承ください。 申込書に必要事項をご記入の上FAXにてお申し込みください。 お申し込み後はキャンセルできませんのでご注意ください。 申込書が届き次第、請求書・聴講券・会場案内図をお送りします。
住所				
TEL		FAX		
	所属部課	氏名(フリガナ)	E-mail	個人情報の利用目的 ・セミナーの受付、事務処理、アフターサービスのため ・今後の新商品、新サービスに関するご案内のため ・セミナー開催、運営のため講師へもお知らせいたします
受講者1				 技術情報協会 TECHNICAL INFORMATION INSTITUTE CO.,LTD. 申込専用FAX 03-5436-5080
受講者2				

今後、定期的な案内を希望されない場合、案内方法に×印をお願いいたします。
(現在案内が届いている方も再度ご指示ください)

[郵送(宅配便)・FAX・e-mail]